

# TSPA4C500x 晶元版本

## 用户手册

- 版本号: A\_Draft
- 版本日期: 2020-03-10
- 文件编号: N/A

## 修订记录

版本	版本日期	修订描述
A_Draft	2020-03-10	SDK 版本 0.7.1;

## 目录

1 晶元版本区别 .....	3
2 晶元版本鉴别 .....	4
2.1 物料编号尾缀 .....	4
2.2 芯片丝印 .....	4
2.3 程序函数 .....	4
3 软件工程配置 .....	5

## 1 晶元版本区别

A2 版本把 A1 版本的部分运行在 FLASH 上的程序固化入了 ROM，从而增大了用户可以使用的 FLASH 空间。

Tropos

## 2 晶元版本鉴别

### 2.1 物料编号尾缀

晶元版本	物料编号/尾缀
A1	TSPA4C500x/A
A2	TSPA4C500x/B

表 2.1: 晶元版本对应物料编号尾缀

### 2.2 芯片丝印

晶元版本	丝印编号
A1	小于“1948”
A2	大于等于“1948”

表 2.2: 晶元版本对应芯片丝印编号

### 2.3 程序函数

用户可以在工程程序中调用函数“`wafer_get_version()`”以查看芯片晶元版本。

## 3 软件工程配置

不同晶元版本使用的软件工程配置不同。SDK 内示例工程默认使用 A2 的配置。

若使用 A2 芯片，则无需更改配置。

若使用 A1 芯片，则需修改 2 处配置：

1. 在文件“in\_config.h”中打开宏定义#define CFG\_TSPA4C500X\_A1(更改此项，需要重新编译并烧录 Bootram)。
2. 在工程文件目录中禁用“lib”，启用“lib\_A1”。

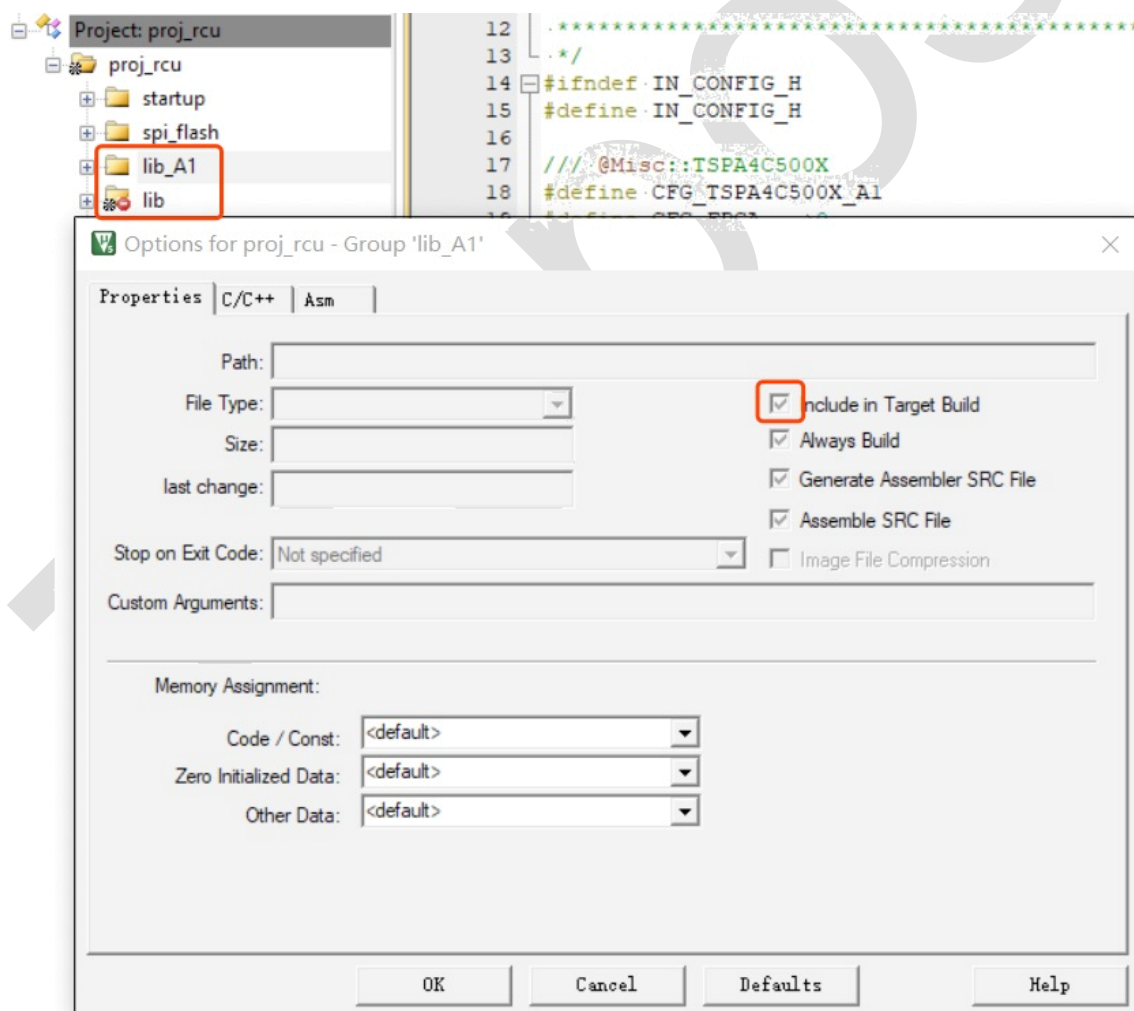


图3.1：启用/禁用 lib